

半导体

证券研究报告

2021年10月12日

台积电单月营收再创新高，A股半导体进入预增窗口

本周行情概览：

本周（20210927-20211008）半导体行情显著跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 2.75%，同期创业板指数上涨 1.10%，上证综指下跌 0.58%，深证综指上涨 0.39%，中小板指下跌 0.14%，万得全 A 下跌 0.87%。半导体行业指数显著跑输主要指数。

半导体制造涨幅居前。半导体细分板块中，半导体制造板块本周上涨 0.6%，分立器件板块本周下跌 0.8%，IC 设计板块本周下跌 0.8%，封测板块本周下跌 1.0%，半导体材料板块本周下跌 5.2%，半导体设备板块本周下跌 5.9%。

台积电 9 月营收达 1,527 亿新台币，创历史新高，印证产业高景气。台积电于 10 月 8 日公布 2021 年 9 月营收，公司 9 月营收达 1526.85 亿元新台币（单位下同），月增 11.1%，年增 19.7%，再创历史新高，累计今年前 9 月合并营收 1 兆 1,492.26 亿元，年增 17.5%，此前公司预计第 3 季营收约 146~149 亿美元。

公司计划于 10 月 14 日 14:00 召开三季度业绩交流会。

A 股半导体已进入三季度业绩预增窗口期，板块有望迎来预增行情。根据天风策略组整理，深证主板、中小板、创业板目前均已进入业绩预增窗口期，10 月 15 日前，深证主板、中小板将有条件强制披露三季度预告，创业板将强制披露三季度预告。三季度半导体周期持续上行，涨价、扩产、产品结构提升延续了二季度的行情，随着公司陆续披露三季度预告，预计板块有望迎来预增行情。

周期上行，加码成长。周期持续上行，涨价+扩产+产品结构提升，让半导体板块二季度迎来戴维斯双击，板块涨幅达 51%，大幅跑赢主要指数。站在三季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产约束在年内难以大规模释放，我们预计供不应求的格局至少持续到年底，高景气度的持续性提供了持续超预期的动力。需求提升和国产替代带来的“量”的增长值得被更加关注，我们判断扩产和国产化的趋势将超出预期，持续看好国产半导体设备材料板块；我们判断车用半导体、IoT、特种 IC 正在量价齐升的初期，手机、PC、电视等结构性升级带来的半导体价值量提升也将助力相关国产设计厂商持续高速增长；我们判断国产半导体制造板块已进入战略扩产期，高景气度背景下，下半年有望量价齐升。

建议关注：

FPGA：紫光国微/复旦微电

半导体设备材料：北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微/ASM pacific

半导体制造封测：中芯国际/华虹半导体/闻泰科技/三安光电/华润微/士兰微/长电科技/通富微电

半导体设计：晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/斯达半导/新洁能/澜起科技/汇顶科技/上海贝岭

风险提示：疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

联系人

chengruiying@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 《半导体-行业研究周报:DDR5 放量在即，新一轮存储器迭代周期将开启》2021-09-27
- 《半导体-行业研究周报:半导体需求持续高企，碳中和时代引领第三代半导体发展热潮》2021-09-19
- 《半导体-行业研究周报:看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料》2021-09-13

内容目录

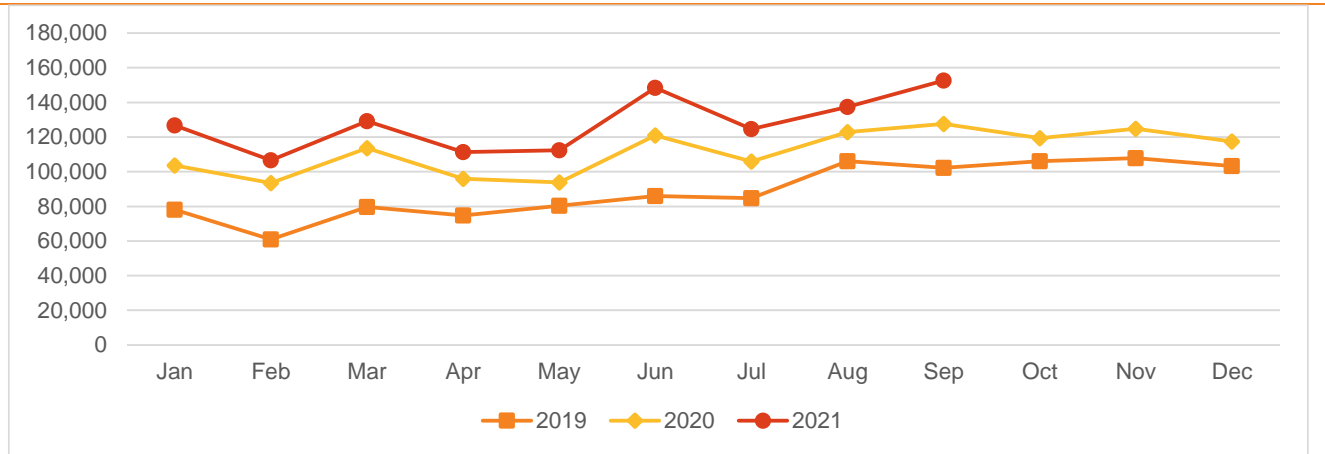
1. 台积电单月营收再创新高，A 股半导体进入预增窗口.....	3
2. 周观点：	4
3. 本周（20210927-20211008）半导体行情回顾	5
4. 本周重点公司公告	6
5. 本周半导体重点新闻.....	9
5.1. IC 设计.....	9
5.2. 设备/材料.....	10
5.3. 代工/封测.....	10
5.4. EDA/IP/其他	11
6. 风险提示：	11

1. 台积电单月营收再创新高，A 股半导体进入预增窗口

台积电 9 月营收达 1,527 亿新台币，创历史新高，印证产业高景气。台积电于 10 月 8 日公布 2021 年 9 月营收，公司 9 月营收达 1526.85 亿元新台币（单位下同），月增 11.1%，年增 19.7%，再创历史新高，累计今年前 9 月合并营收 1 兆 1,492.26 亿元，年增 17.5%，此前公司预计第 3 季营收约 146~149 亿美元。

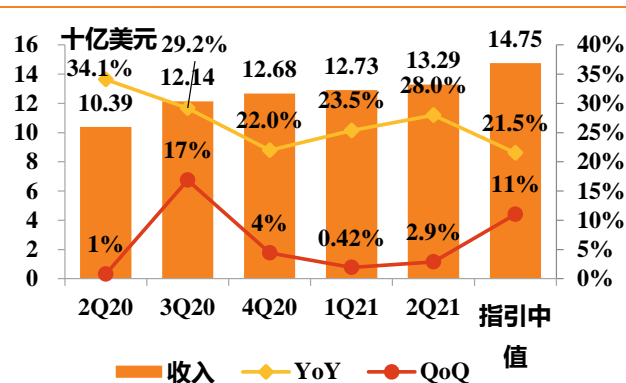
公司计划于 10 月 14 日 14:00 召开三季度业绩交流会。

图 1：台积电月度营收（百万新台币）



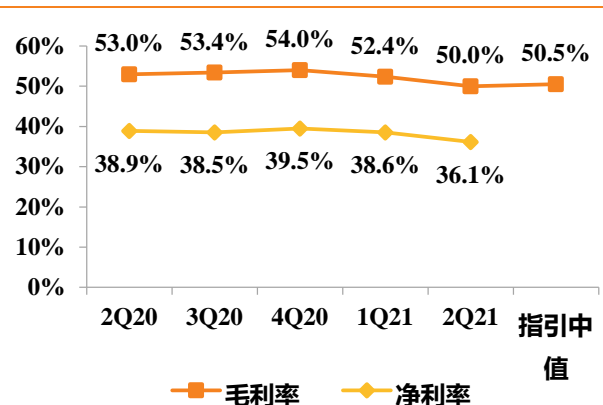
资料来源：公司官网，天风证券研究所

图 2：台积电季度营收



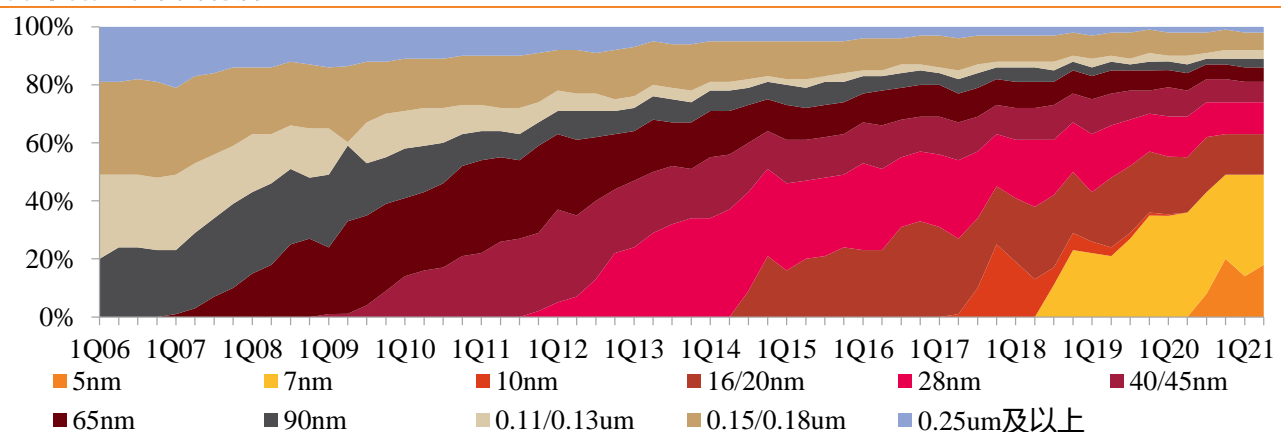
资料来源：公司公告，天风证券研究所

图 3：台积电季度毛利率与净利率



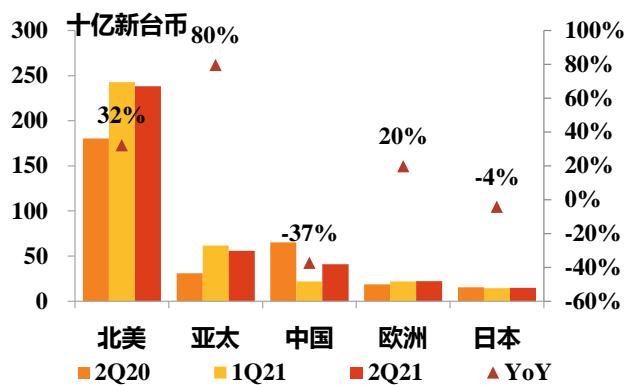
资料来源：公司公告，天风证券研究所

图 4：台积电制程营收占比



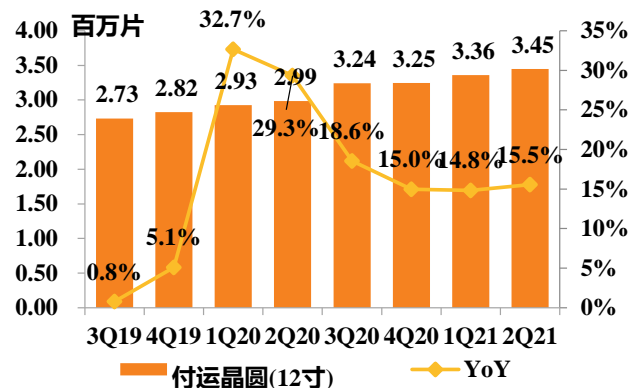
资料来源：公司官网，天风证券研究所

图 5：台积电营收分地区



资料来源：公司公告，天风证券研究所

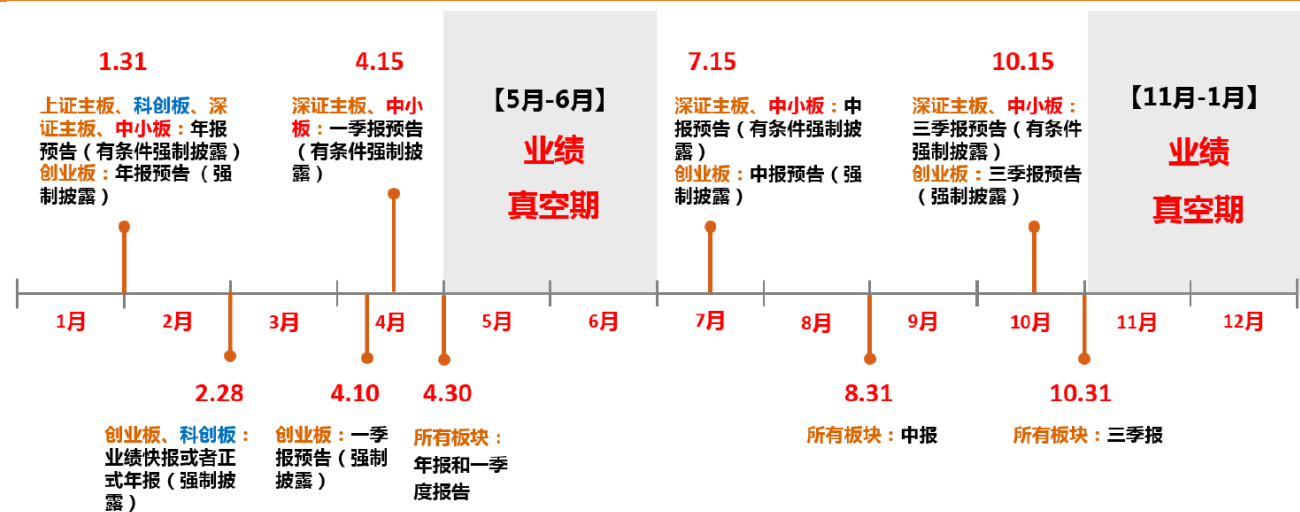
图 6：台积电付运晶圆



资料来源：公司公告，天风证券研究所

A 股半导体已进入三季度业绩预增窗口期，板块有望迎来预增行情。根据天风策略组整理，深证主板、中小板、创业板目前均已进入业绩预增窗口期，10 月 15 日前，深证主板、中小板将有条件强制披露三季度预告，创业板将强制披露三季度预告。三季度半导体周期持续上行，涨价、扩产、产品结构提升延续了二季度的行情，随着公司陆续披露三季度预告，预计板块有望迎来预增行情。

图 7：业绩披露时间轴



- 1、有条件披露指的是满足以下条件必须披露：1）归母净利润为负值；2）净利润与上年同期相比上升或者下降 50% 以上（基数过小的除外）；3）扭亏为盈。
- 2、创业板一季报预告：年报预约披露时间在 3 月 31 日之前的，应当最晚在披露年报时，披露一季报预告；年报预约披露时间在 4 月份的，应当在 4 月 10 日之前披露一季报预告。
- 3、创业板和科创板，年报预约披露时间在 3-4 月份的，需在 2 月底之前披露业绩快报。

资料来源：Wind，天风证券研究所策略组

2. 周观点：

周期上行，加码成长。周期持续上行，涨价+扩产+产品结构提升，让半导体板块二季度迎来戴维斯双击，板块涨幅达 51%，大幅跑赢主要指数。站在第三季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产约束在年内难以大规模释放，我们预计供不应求的格局至少持续到年底，高景气度的持续性提供了持续超预期的动力。需求提升和国产替代带来的“量”的增长值得被更加关注，我们判断扩产和国产化的趋势将超出预期，持续看好国产半导体设备材料板块；我们判断车用半导体、IoT、特种 IC 正在量价齐升的初期，手机、PC、电视等结构性升级带来的半导体价值量提升也将助力相关国产设计厂商持续高速增长；我们判断国产半导体制造板块已进入战略扩产期，高景气度背景下，下半年

有望量价齐升。

半导体制造：扩产涨价，量价齐升。涨价+UTR 提升+产品结构优化，二季度半导体制造板块景气度进一步提升。二季度制造板块营收同比增 45%，归母净利润同比增 261%。我们判断本土制造已进入战略扩产期，下半年有望迎来涨价行情。建议关注：中芯国际/华虹半导体

IC 设计：从“价提”到“量增”。“涨价”仍是关键词，二季度板块业绩大增，验证景气度。二季度 IC 设计板块营收同比提升 60%，归母净利率环比提升至 22%。二季度半导体供需格局持续紧俏，部分产品持续涨价，高景气度带动了板块业绩提升。下半年随着晶圆代工的涨价，预计部分 IC 设计厂商有能力向下游转嫁，下半年缺货涨价会持续。从“价提”到“量增”，重视新产品、新市场带来的新机遇。建议关注：韦尔股份/紫光国微/卓胜微/兆易创新/圣邦股份/澜起科技/北京君正/瑞芯微/思瑞浦/汇顶科技/晶晨股份/恒玄科技/富瀚微/上海贝岭/晶丰明源/全志科技。

半导体设备材料：持续受益扩产+国产化。扩产周期向上，二季度营收高增长。二季度半导体行业产能持续紧缺，多处工厂在执行扩产计划，半导体设备材料板块营收端实现高速增长，设备板块二季度营收增长 52%，材料板块营收增长 61%。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力大。建议关注：北方华创/雅克科技/精测电子/华峰测控/长川科技/中微公司/芯源微/有研新材/上海新阳/华特气体/至纯科技/盛美半导体

3. 本周（20210927-20211008）半导体行情回顾

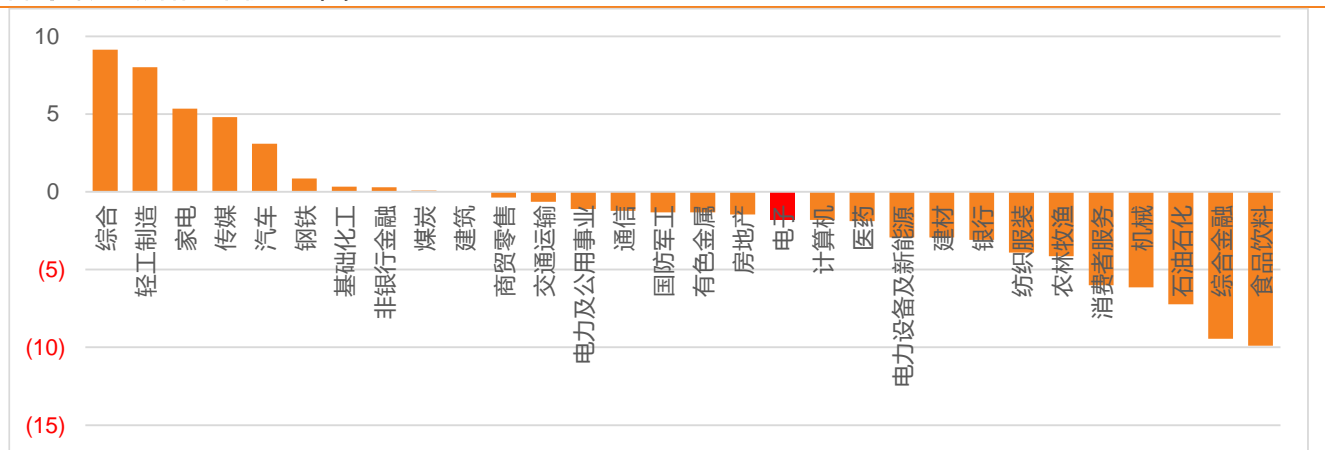
本周（20210927-20211008）半导体行情显著跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌 2.75%，同期创业板指数上涨 1.10%，上证综指下跌 0.58%，深证综指上涨 0.39%，中小板指下跌 0.14%，万得全 A 下跌 0.87%。半导体行业指数显著跑输主要指数。

表 1：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	1.10	-3.86
上证综合指数	-0.58	-2.18
深证综合指数	0.39	-3.15
中小板指数	-0.14	-2.61
万得全 A	-0.87	-1.88
半导体（申万）	-2.75	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

图 8：本周 A 股各行业行情对比 (%)

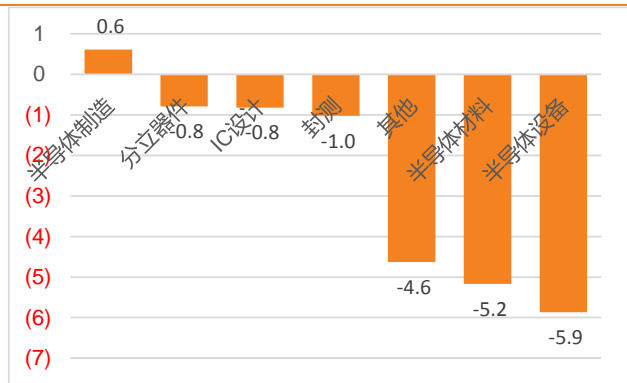


资料来源：Wind，天风证券研究所

半导体制造涨幅居前。半导体细分板块中，半导体制造板块本周上涨 0.6%，分立器件板块本周下跌 0.8%，IC 设计板块本周下跌 0.8%，封测板块本周下跌 1.0%，半导体材料板块

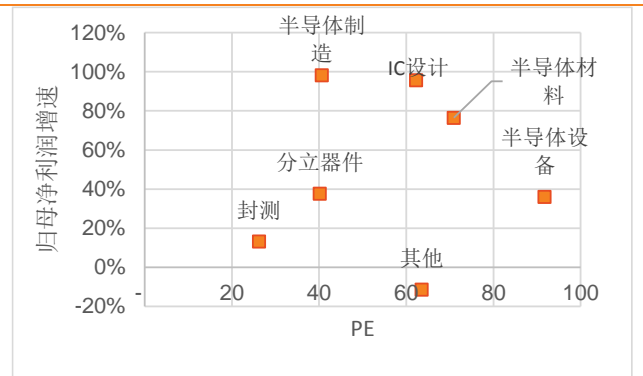
本周下跌 5.2%，半导体设备板块本周下跌 5.9%。

图 9：本周子板块涨跌幅（%）



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 10：半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：晓程科技、正帆科技、思瑞浦、扬杰科技、澜起科技、上海贝岭、汇顶科技、三安光电、捷捷微电、恒玄科技。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：晶盛机电、隆华科技、和林微纳、国科微、赛微电子、苏州固锴、永太科技、华特气体、南大光电、巨化股份。

表 2：本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅
晓程科技	18.6%	晶盛机电	-8.1%
正帆科技	9.7%	隆华科技	-8.7%
思瑞浦	8.9%	和林微纳	-9.0%
扬杰科技	8.2%	国科微	-9.2%
澜起科技	5.7%	赛微电子	-10.0%
上海贝岭	5.2%	苏州固锴	-10.1%
汇顶科技	5.2%	永太科技	-10.6%
三安光电	4.5%	华特气体	-12.0%
捷捷微电	3.8%	南大光电	-14.7%
恒玄科技	2.6%	巨化股份	-15.8%

资料来源：Wind，天风证券研究所

4. 本周重点公司公告

【华特气体 688268.SH】

公司于 2021 年 10 月 9 日公告《关于公司光刻气产品获得日本 GIGAPHOTON 株式会社合格供应商认证函的自愿性披露公告》。公司四款光刻气产品（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）均通过了日本 GIGAPHOTON 株式会社的合格供应商认证。公司本次获得日本 GIGAPHOTON 株式会社合格供应商认证函体现光刻机激光设备厂商对公司产品的认可。考虑到激光设备厂商本身不直接采购光刻气体，光刻气产品销售均须经下游制造商认证，且需一定的认证周期。本次认证事项不会对公司的光刻气产品销售产生直接影响。敬请广大投资者注意投资风险。

【三安光电 600703.SH】

公司于 2021 年 10 月 8 日公告《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）持有本公司股份数量为 243,618,660 股，占公司总股本比例为 5.44%。三安集团本次办理股份解除质押 12,200,000 股，其累计质押股份数量为

100,130,000 股，占其所持有本公司股份的 41.10%。厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）持有本公司股份数量为 1,213,823,341 股股份，占公司总股本比例为 27.10%。三安电子本次办理股份解除质押 22,000,000 股，其累计质押股份数量为 403,720,084 股，占其所持有本公司股份的 33.26%。三安电子及其控股股东三安集团合计持有本公司股份数量为 1,457,442,001 股股份，占公司总股本比例为 32.54%。本次三安电子及三安集团部分股票解除质押后，两家累计质押股票 503,850,084 股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的 34.57%。本公司于 2021 年 10 月 8 日收到公司控股股东三安集团及三安电子的通知，三安集团将其质押给国家开发银行厦门市分行的 12,200,000 股股份、三安电子将其质押给厦门国际信托有限公司的 22,000,000 股股份办理解除质押手续。

【晶晨股份 688099.SH】

公司于 2021 年 9 月 25 日公告《关于出售参股公司部分股权的公告》。公司控股子公司上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶毅”）于 2021 年 6 月 30 日签署了《B 轮股权转让及增资协议》，协议约定上海晶毅将其持有的部分芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来半导体”）的股权分别转让给上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）及北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联”或“交易对方”）。本次转让股权比例为 2.2205%，转让对价为 1,998.41 万元人民币（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。经公司自查发现，上述股权转让事项预计产生投资收益约人民币 2,067.03 万元，此外，因上海晶毅对芯来半导体不再派驻董事，不再实施重大影响，公司将对其由“权益法”改为“公允价值计量”核算，核算科目由“长期股权投资”变更为“交易性金融资产”，拟增加合并报表净利润约 1,722.05 万元，本次股权转让事项及对芯来半导体核算方法的变更预计增加公司 2021 年下半年净利润合计约 3,789.08 万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且超过 100 万元，达到董事会审议及披露标准。公司前期未关注到上述交易产生的投资收益达到董事会审议及披露标准，公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议补充审议了上述事项。

【盛剑环境 603324.SH】

公司于 2021 年 9 月 24 日公告《关于重大项目中标的公告》。公司收到鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（以下简称“源盛光电”）出具的《中标通知书》，确认公司作为联合体牵头人中标鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司剥离液循环 利用项目，项目中标总价为人民币 5,560.00 万元（含税）。源盛光电是京东方科技集团股份有限公司的全资子公司，源盛光电第 5.5 代 LTPS/AMOLED 生产线于 2013 年在内蒙古鄂尔多斯点亮投产，产品定位主要为中小尺寸 LTPS 及 AMOLED 高端显示器件，是中国自主创新、自主技术的全球最先进新型半导体显示器件生产线之一。本项目中标体现了公司在湿电子化学品回收再生领域的竞争优势及项目执行能力，项目的顺利实施将对公司未来的湿电子 化学品相关业务的业绩产生积极影响。

【太极实业 600667.SH】

公司于 2021 年 9 月 25 日公告《关于子公司十一科技中标重大项目工程的进展公告》。近日，公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技与山西新阳中来新能源科技有限公司完成了《建设项目工程总承包合同》的正式签署。项目位于山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区，大运路以西，真武路以东，北格街以北，规划街以南。本次工程主要建设内容包括：2 座生产车间、7 座生产辅助用房（动力站、废水处理站、空分站、笑气站、硅烷站、磷烷站、氨气站）、6 座仓储用房（综合仓库、产品仓库、化学品库 1、化学品库 2、危废仓库、固废仓库），并配套建设 1 座科研综合楼（中来新能源科技馆）、1 座职工宿舍楼、3 座门卫室、连廊、地下建筑及室外构筑物等。同时建设配套公用工程和辅助设施，包括给排水、供电、采暖、供气、消防、道路等。双方已完成合同的签署，合同已生效，将对公司未来经营业绩产生积极影响；合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖；合同的签署体现了十一科技在国内光伏产业工程总包业务领域的重要地位，合同的履行有利于十一科技未来新业务的开拓。

【振华科技 000733.SZ】

公司于 2021 年 9 月 30 日公告《**振华新云拟收购股权所涉及的贵州新云科技股东全部权益价值资产评估报告**》。北京中天华资产评估有限责任公司接受中国电子信息产业集团有限公司和中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）的共同委托，对中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）拟收购股权所涉及的贵州振华新云科技有限公司股东全部权益价值进行了评估，为拟进行的股权收购行为提供价值参考依据。根据评估目的，本次评估对象为贵州振华新云科技有限公司股东全部权益，评估范围是贵州振华新云科技有限公司于评估基准日的全部资产及相关负债，具体评估范围以贵州振华新云科技有限公司提供的资产负债表和资产评估申报表为基础。资产基础法评估结果：贵州振华新云科技有限公司在评估基准日 2021 年 6 月 30 日申报的总账面资产总额 3,056.93 万元、总负债 1,342.60 万元、净资产 1,714.33 万元；总资产评估值为 4,835.25 万元，增值额为 1,778.32 万元，增值率为 58.17%；总负债评估值为 983.31 万元，减值额为 359.29 万元，减值率为 26.76%。净资产评估值为 3,851.94 万元，增值额为 2,137.61 万元，增值率为 124.69%。收益法评估结果：贵州振华新云科技有限公司股东全部权益价值为 4,817.71 万元，评估增值 3,103.38 万元，增值率为 181.03%。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即贵州振华新云科技有限公司股东全部权益价值为 3,851.94 万元。

【沪硅产业 688126.SH】

公司于 2021 年 10 月 1 日公告《**关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的公告**》。公司实际经营环境较 2019 年股票期权激励计划制定时发生了较大变化，原激励计划中所设定的部分业绩考核目标和当前公司发展环境及战略方向有一定的差异。若沿用原业绩考核目标，将减弱甚至失去股票期权激励计划对于核心员工的实际激励作用，不利于公司长远发展，并最终损害公司股东利益。依据实际情况，为保护公司及股东的长期利益，合理调动公司核心员工的积极性和创造性，公司拟修订股票期权激励计划中的部分业绩考核目标。本次调整股票期权激励计划中的部分业绩考核目标，是公司根据实际经营环境所采取的有效应对措施。在当下百年未遇之全球大变局的特殊时期，公司未来发展的市场环境仍然严峻，要完成调整后的公司业绩考核目标依然具有一定的挑战性。半导体制造企业作为高科技企业，具有投资规模大、固定成本高的特点，国内外半导体制造型企业经常采用息税折旧摊销前利润（EBITDA）指标，该指标能剔除负债和折旧的影响，较好的反映出公司的盈利能力和经营性现金流产生的能力，是较好的衡量公司价值创造的综合性指标。因此，本次业绩考核目标调整，除保留净利润指标外，还增设了息税折旧摊销前利润（EBITDA）的可选指标。本次业绩考核目标调整同时还调高了营业收入增长率考核指标，由 8% 年增长率提高到 12% 年增长率，体现了公司的成长性。综上，本次调整设置两类可供选择的利润考核指标，同时适当提高营收增长率指标，有助于公司动态适应外部变化，鼓励管理层落实“逆周期”投资战略，更加有利于公司结合实际情况，着眼于长远发展，并能充分发挥激励对象的积极性和创造性，进一步提高公司的竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展。此外，考虑到此次业绩考核目标调整的合理性，经董事会薪酬与考核委员会同意，本次业绩考核目标调整后，公司高级管理人员将放弃 2021 年度行权额度，但仍保留 2022 年度行权额度。

【北方华创 002371.SZ】

公司于 2021 年 10 月 8 日公告《**2021 年前三季度业绩预告**》。2021 年前三季度营业收入 576,451.55 万元-659,380.65 万元，同比+50.29%-71.91%；归母净利润 59,536.04 万元-70,936.63 万元，同比+82.30%-117.21%。2021 年前三季度，受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长，使得公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。

【扬杰科技 300373.SZ】

公司于 2021 年 10 月 8 日公告《**2021 年前三季度业绩预告**》。2021 年前三季度归母净利润 53,792.66 万元-57,728.70 万元，同比+105%-120%。2021 年经济复苏，功率半导体国产替代加速，半导体行业景气度高。扬州地区虽然 8 月份短期受疫情影响，但受益于国

家以及地区出台的利好政策，公司抓住机遇，迅速复工扩产，进一步提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，1-9月销售收入同比增长70%以上。公司前期整合研发团队，加大研发投入，积极推进重点研发项目的管理实施，深入了解客户需求的基础上，加快新产品的研发速度，促使新产品释放效益，新产品业绩突出。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为2550万元至2650万元。

【飞凯材料 300398.SZ】

公司于2021年10月8日公告《2021年前三季度业绩预告》。2021年前三季度归母净利润23,766.26万元-27,161.44万元，同比+40%-60%。报告期内，虽然国内外疫情仍有所反复，但是公司按照年度经营计划有序推进各项工作，践行多元化新材料产品战略，努力开拓市场，使得公司本期业务实现了较大的增长。其中，屏幕显示材料受益于国产化率持续提升、正性光刻胶业务的大幅增长以及新产品负性光刻胶开始形成销售，本报告期营业收入实现较大增长；半导体材料受到下游需求增加的影响，本报告期营业收入增长较大；紫外固化材料受到下游需求增长，以及塑胶表面处理型功能材料业务拓展的影响，本报告期营业收入实现一定增长；有机合成医药中间体产品近期受到下游新需求的影响，本报告期营业收入实现大幅增长。预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为3,219.27万元(未扣除所得税影响)，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为4,692.75万元(未扣除所得税影响)。

【利扬芯片 688135.SH】

公司于2021年10月9日公告《2021年前三季度业绩预告的自愿性披露公告》。预计2021年前三季度实现营业收入26,800万元至28,100万元，与上年同期相比，将增加人民币9,207万元至10,507万元，同比增加52%到60%。预计2021年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币7,700万元至8,200万元，与上年同期相比，将增加人民币4,641万元至5,141万元，同比增加152%到168%。预计2021年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币7,300万元至7,750万元，与上年同期相比，将增加4,421万元至4,871万元，同比增加154%到169%。伴随国内集成电路产业蓬勃发展，行业景气度持续提升，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，引进优质客户，客户结构发生变化。同时，随着募投项目逐步推进，测试产能逐渐释放并产生效益，公司2021年前三季度延续在5G通讯、MCU、AIoT等领域的芯片测试增长趋势。公司2021年第三季度测试订单饱满，产能处于满负荷运转状态，第三季度（2021年7月1日-9月30日）营业收入为10,849万元至12,149万元，较上年同期（2020年7月1日-9月30日）5,154万元大幅增加111%至136%，并创公司成立以来单季度历史新高。公司2021年第三季度营业收入大幅上升，规模效应使得固定成本分摊降低，第三季度（2021年7月1日-9月30日）归属于母公司所有者的净利润为3,737万元至4,237万元，较上年同期（2020年7月1日-9月30日）364万元大幅增加927%到1064%；第三季度（2021年7月1日-9月30日）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,748万元至4,198万元，较上年同期（2020年7月1日-9月30日）291万元大幅增加1188%到1342%。

5. 本周半导体重点新闻

5.1. IC设计

中国台湾几家IC设计公司准备从2021年第四季度开始提高芯片价格，以反映制造成本的上升。《电子时报》报道援引上述人士称，联发科、DDI巨头联咏、网络芯片大厂瑞昱、服务器外围芯片制造商祥硕、主板管理控制器制造商信骅都有能力将不断上升的成本转嫁给客户，并将从10月以及2022年第一季度开始提价。其中，联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，特别是包括MT7668和MT7663系列在内的Wi-Fi解决方案的价格，上调幅度最高可达30%。联咏方面，尽管近期LCD面板需求和价格疲软，但其仍计划将驱动芯片价格上调5-10%，新价格将从11月开始生效，并将在10月份将其SoC芯片价格上调10-20%。瑞昱已通知其客户，其所有产品的价格将上调约15%，新价

格将于 10 月 1 日生效。今年 9 月，瑞昱已将其部分 Wi-Fi 芯片解决方案的价格上调了 10-15%。(集微网)

集成电路工程技术人员国家职业技术技能标准发布。近日，人力资源社会保障部与工业和信息化部联合颁布了集成电路、人工智能、物联网、云计算、工业互联网、虚拟现实工程技术人员和数字化管理师等 7 个国家职业技术技能标准。(集微网)

旺季后设计厂 Q4 业绩恐承压 TDDI、MCU 厂预测保守。传统旺季之下，IC 设计厂第三季度纷纷交出亮眼成绩单，联发科、瑞昱、联咏等更是创下历史新高，然而第四季度淡季到来，叠加外部不确定因素纷扰，已有部分大厂作出保守预测，业绩承压在即。据台媒《经济日报》报道，第三季度为传统旺季，设计厂第四季度业绩通常会自高峰下滑，今年情况更加特殊，东南亚疫情、中国大陆限电措施成为两大变数，或将加剧产业链缺货情况，设计厂第四季度下滑压力陡增。(集微网)

外资看驱动 IC 展望较半年前更保守，明年毛利率恐续降。外资近日邀请驱动 IC 相关业者参与研讨会，驱动 IC 业者仍尚未与面板厂谈定第四季价格，外资认为，面板厂试图延迟价格谈判，借此取得更低的价格，联咏认为，由于公司电视驱动 IC 属于高阶市场，受影响程度可望小于同业。外资认为，驱动 IC 业者展望转趋保守，高毛利趋势恐难延续。(集微网)

SK 海力士携手新发集团将在无锡打造集成电路园区。韩联社报道，SK 海力士与中国新发集团共同出资 20 亿元，将在无锡打造集成电路产业园。据无锡市人民政府 8 日在官网上传的媒体报道，SK 海力士和新发集团共同打造的“无锡韩中集成电路产业园”项目 7 日开工。SK 海力士从 2006 年起在无锡开设运营动态随机存取存储器 (D-RAM) 半导体工厂。为加强与当地企业和社区的双赢合作，确保供应链稳定，SK 海力士参与上述园区建设。公司方面称，此次投资非用于扩建现有半导体工厂。(Wind)

5.2. 设备/材料

日经中文网：日本的半导体材料厂商将相继开始增强产能。其中，硅晶圆厂商 SUMCO 在 9 月 30 日宣布投资 2287 亿日元，增产最先进的直径 300 毫米晶圆。除了建设新工厂外，还将增强子公司的生产设备。富士胶片控股 (HD) 将在到 2023 财年 (截至 2024 年 3 月) 的 3 年里，向半导体材料业务投资 700 亿日元。核心是在硅晶圆上转印电路图案的光刻设备使用的光刻胶 (感光材料)。将向静冈县工厂投入 45 亿日元，提高最尖端的 EUV (极紫外) 光刻胶的产能。住友电木将对中国子公司苏州住友电木有限公司投入 25 亿日元，建设新生产线。针对排在全球份额首位的半导体封装材料，把产能增至 1.5 倍。(集微网)

北方华创：受上游零部件交付周期影响 公司半导体设备交付周期约为 6-9 个月。近日，北方华创在接受机构调研时表示，目前受上游零部件交付周期影响，公司半导体设备的交付周期约为 6-9 个月。公司的研发费用主要用于刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等设备技术提升和应用领域拓展。(集微网)

Yole：中国大陆已经成为全球外延设备的主要驱动力量。10 月 7 日，著名半导体分析机构 Yole Développement 发布了《后摩尔时代的外延设备》报告。报告预测，到 2026 年，全球外延设备的总市场规模将达到 11 亿美元。高温化学气相沉积 (HTCVD) 市场规模将在 2026 年达到 3.93 亿，2020-2026 年复合增长率为 9.5%。分子束外延设备 (MBE) 将在 2026 年达到 6800 万美元的市场规模，2020-2026 年复合增长率为 7.1%，金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 设备到 2026 年市场规模达 6.3 亿美元，2020-2026 年复合增长率为 7%。(集微网)

5.3. 代工/封测

三星发布 2nm 计划，晶圆代工竞争走向新节点。在近日召开的“Samsung Foundry Forum 2021” (晶圆代工论坛)上，三星电子总裁兼代工业务负责人 Siyoung Choi 公布了有关 3nm/2nm 工艺的量产计划，同时发布新的 17nm 工艺，强化对传统工艺市场的争夺。与此同时，台积电也在积极推进 3nm/2nm 工艺、28nm 工艺的建厂与开发。随着摩尔定律

的持续演进，三星与台积电在晶圆代工领域的新一轮竞争再度展开。(集微网)

台积电：9月营收达1526.85亿新台币 再创历史新高。晶圆代工龙头台积电10月8日公布的财报显示，该公司9月营收达1526.85亿元新台币(单位下同)，月增11.1%，年增19.7%，再创历史新高，累计今年前9月合并营收1兆1,492.26亿元，年增17.5%。(集微网)

代工扩产、硅片涨价 再生晶圆量价齐升国产化加速。半导体涨价潮进入下半场，虽然需求疲软迹象频现，但随着代工厂预告已久的第一批新产能进入开工关键期，市场对硅晶圆的强烈需求已清晰可见，而一向作为“副产品”存在的再生晶圆，也由此获得前所未有的瞩目。近期不断有媒体报道指出，再生晶圆供不应求，前四大厂商中，中砂、升阳、辛耘均表示，今年新增产能已全部满载。业内指出，再生晶圆作为代工厂测试制造工艺中，用以提高成品率和降低生产成本的关键材料，需求正在大幅增加。(集微网)

供应商对台积电实现今年营收增超过20%的总目标表示乐观。据digitimes10月4日报道，有观点认为，苹果和联发科分别削减5nm和7nm芯片订单可能导致台积电无法实现今年超过20%的营收增长目标。尽管如此，台积电供应商的消息人士仍对该代工厂今年剩余时间的销售前景持乐观态度。市场猜测苹果削减与台积电的5nm芯片订单，联发科将其和台积电合作的7nm芯片订单削减约20%。但据业内消息人士称，台积电有望在2022年下半年将3nm工艺技术投入量产，该工艺的月产量将达到55000片。台积电的3nm工艺将首先用于制造iPhone芯片。(集微网)

集邦咨询：因面板价跌及晶圆代工涨价 Q4驱动IC价格或将小幅调涨。TrendForce发文指出，以面板所使用的半导体来说，分为驱动IC、TCON与LCD PMIC，各应用IC价格走势随着供需变化而不尽相同，部分驱动IC的价格仍可望优于业界之前的预期，不会随着面板价格下滑而下跌。电视、Chromebook与IT消费性机种的驱动IC因为需求率先转弱，加上面板厂在该类驱动IC已经累积一定的库存水位，该类驱动IC在第四季将可能出现冻涨情形，但在IT商务机种的驱动IC仍有需求支撑的状况下，虽然无法将晶圆代工成本完全转嫁给面板厂，但预期面板厂仍有规避缺货风险的疑虑，驱动IC价格仍有机会小幅度调涨。(Wind)

5.4. EDA/IP/其他

比昂芯科技完成千万级天使轮融资，仿真万物引领后摩尔时代大模拟 EDA 未来。近日，深圳市比昂芯科技有限公司宣布完成数千万天使轮融资，由英诺天使领投，复星创富、临港科创联合投资。比昂芯成立于2020年10月，是一家开发和销售多款面向后摩尔时代大模拟(先进封装和高速/射频设计)的EDA工具的公司，致力于填补国产EDA产业链空白。(集微网)

国调基金在滁州落户设立战略新兴基金 重点投向半导体、汽车装备等产业。9月28日，国调战略性新兴产业投资基金(滁州)签约仪式在滁举行。国调基金信息显示，国调战略性新兴产业投资基金(滁州)是由国调基金牵头、与滁州市相关国有企业共同作为基金投资人发起设立的股权投资基金，基金总规模100亿元，委托诚通基金管理运营。基金秉承“市场化、专业化”理念，围绕安徽滁州等长三角区域的战略新兴产业开展投资，重点投向光伏、锂电池、半导体、汽车装备等产业。(集微网)

6. 风险提示：

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com